

### DeepCleave von Holo/OR

## Dickes Glas gleichmäßig mit dem Laser schneiden

LASER COMPONENTS vertreibt mit dem DeepCleave Modul von Holo/OR erstmals eine vollständig optische Lösung für gleichmäßige Schnitte in dicken transparenten Materialien wie Flat Panels für Mobiltelefone. Über ein Linsensystem mit einem integrierten diffraktiven optischen Element wird ein Singlemode-Laserstrahl so gebündelt, dass er in Strahlrichtung (Z-Achse) statt der normalen Strahltaile auf einer Länge bis zu 2 mm eine langgezogene Brennlinie mit gleichförmiger Intensitätsverteilung aufweist. In diesem Bereich hat der Strahl einen gleichbleibenden Durchmesser von 1,8 µm.

Das in einen Tubus gebettete System entspricht einem Objektiv mit einer Numerischen Apertur von 0,35 und kann sofort eingesetzt werden. Zusätzliche Objektive oder kostspielige Optiken werden nicht benötigt. Zusammen mit einem DOE von Holo/OR ist in dem DeepCleave Modul auch das aufwendige optische System integriert, das zur Erzeugung der langgezogenen Brennlinie mit konstanter Leistungsdichte nötig ist. Voraussetzung dafür ist ein Eingangsstrahl mit einer genau definierten Größe und einem geringen  $M^2$ .

Bei der Massenproduktion von Gläsern für Handys, Displays, Solarzellen und andere High-End-Anwendungen müssen innerhalb kürzester Zeit lange, präzise Schnitte durchgeführt werden. 500 mm pro Sekunde sind dabei keine Seltenheit. Die Qualität dieser Schnitte hat entscheidenden Einfluss auf Flexibilität und Haltbarkeit der Bauteile. Geformte Singlemode-Laserstrahlen mit einem langgezogenen Fokus in der Z-Achse können gleichmäßig ins Material eindringen und so optimale Ergebnisse liefern.

**Weitere Informationen** [www.lasercomponents.com/de/produkt/diffraktive-elemente-zur-strahlprofil-aenderung/](http://www.lasercomponents.com/de/produkt/diffraktive-elemente-zur-strahlprofil-aenderung/)

### Messen

**22. Breitbandkongress des FRK**, 23. – 24. September 2019, H4 Hotel, Leipzig

**ECOC**, 22. – 25. September 2019, Dublin, Irland, **Stand 337**

**Measurement World**, 24. – 26. September, Paris expo Porte de Versailles, Frankreich

**JNPLI**, 25. – 26. September 2019, Strasbourg, Frankreich

**Photonex Europe**, 09. – 10. Oktober 2019, Ricoh Arena, Coventry, UK, **Stand D15**

### Das Unternehmen

LASER COMPONENTS hat sich auf die Entwicklung, Herstellung sowie den Vertrieb von Komponenten und Dienstleistungen für die Lasertechnik und Optoelektronik spezialisiert. Seit 1982 steht das Unternehmen seinen Kunden mit Verkaufsniederlassungen in fünf Ländern zur Verfügung. Die Eigenproduktion an verschiedenen Standorten in Deutschland, Kanada und den USA wird seit 1986 verfolgt und macht etwa die Hälfte des Umsatzes aus. Derzeit beschäftigt das Familienunternehmen weltweit über 230 Mitarbeiter.